

新产品发布!

可通DC, 超薄

功分器/合路器

Z3PD-63SMP+

3 Way-0° 50Ω 150 MHz 至6000 MHz

优势

- 宽频带范围, 150 MHz至6000 MHz
- 低插入损耗, 1.0 dB
- 良好的隔离度, 20 dB
- 超薄型封装, 仅高10.92 mm



CASE STYLE: UU1332-1

产品介绍

Mini-Circuits Z3PD-63SMP+ 3路0°带接头宽带功分器/合路器, 覆盖频率为150 MHz至6000 MHz, 支持广泛的应用。该元件作为功分器使用时, 可承受高至5 W的射频功率, 并提供极低的插损, 良好的隔离度、极低的相位及幅度不平衡度。采用超薄铝合金封装(75.95x144.02x10.92 mm), 配有SMP快插接头, 节省空间, 适用于密集系统布局中。

主要特征

特征	优势
宽频带, 150 MHz至6000 MHz	Z3PD-63SMP+频率范围宽, 可支持多种应用。
超薄封装, 尺寸为75.95x144.02x10.92 mm	适用于密集系统布局中, 为系统节省空间。
盲插SMP接头	配有盲插SMP接头, 可与邻近元件直接连接。薄型封装有助于降低系统总高度。
用作功分器时, 可承受高至5 W输入功率	支持多种大功率应用。
极低的插损, 1.0 dB	结合了5 W最高射频功率及低插损, Z3PD-63SMP+分配信号的同时保持良好的信号传输。
极低的不平衡度 • 相位不平衡度: 4° • 幅度不平衡度: 0.5 dB	Z3PD-63SMP+可输出几近相同的输出信号, 适用于平行通路/多通路系统中。
可通过高达750 mA的直流(每个端口为250 mA, 端口1-端口3)	可用于需要直流电通过射频线路的系统中。

注释:

A. 本档未给出的性能和质量属性及条件不构成此规格书的一部分。

B. 本规格书中所给的电气指标和性能数据全部基于Mini-Circuits所选用的测试标准及测试指引下所获得。

C. 本规格书所涉及的器件受Mini-Circuits标准的有条件质量保证和销售条款的约束(统称“标准条款”), 该器件的买家享有标准条款所规定的权利和利益。对于完整的标准条款、专有权利及维修声明, 请访问Mini-Circuits网站, www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp。